

第 151 回研究会

2016 年度精密工学会秋季大会学術講演会 オーガナイズドセッション「プラナリゼーション CMP とその応用」

開催場所: 茨城大学 水戸キャンパス

プラナリゼーション CMP とその応用(1)

9月8日 9:00~10:20 D室

D61

研磨スラリー中のシリカ粒子に着目したシリコンウェーハ外周部の平坦度向上

○戸田智之・山崎智基・宮本泰成・村上陽平（ニッタ・ハース）

D62

蛍光ナノプローブを用いたブラウン運動解析に基づくナノ粒子粒径計測（第2報）—光子相関法による並進拡散係数計測—

○林 照剛・世利俊樹・黒河周平・松川洋二（九州大）

D63

CMP スラリーろ過用微細多孔質膜フィルターのろ過寿命延長

○角屋正人・中川光俊（日本ポール）

D64

難加工基板の CMP におけるスラリーフロー評価法に関する研究—液膜厚み方向のスラリー流れ場と研磨パッド表面構造の関係—

○冨家勇一・畝田道雄（金沢工大）・堀田和利・玉井一誠・森永 均（フジミインコーポレーテッド）・石川憲一（金沢工大）

プラナリゼーション CMP とその応用(2)

9月8日 10:40~12:00 D室

D66・D67 （キーノートスピーチ）

パワーエレクトロニクス革新の意義—国内の現状と産総研の取り組み—

○奥村 元（産総研）

D68

触媒表面基準エッチング法における被毒物除去による加工速度安定化手法の開発

○中平雄太・磯橋 藍・Bui Pho・稲田辰昭・藤 大雪・松山智至・佐野泰久・山内和人（大阪大）

D69

酸化剤を用いた SiC 鏡面研削に関する研究

○細川仁志・小船心之輔・山田洋平・池野順一（埼玉大）

プラナリゼーション CMP とその応用(3)

9月8日 13:00~14:00 D室

D73

研磨パッドの表面アスペリティモデルに基づく動的な材料特性の分析

○大鹿真悟・鈴木教和（名古屋大）・橋本洋平（金沢大）・社本英二（名古屋大）

D74

両面同時研磨を対象とした上定盤研磨パッドの表面性状測定装置の試作と基礎検討

○早川光祐・畝田道雄（金沢工大）・澁谷和孝・中村由夫・市川大造（不二越機械工業）・石川憲一（金沢工大）

D75

熱計測を利用した局所的な研磨効率の新しいその場観察手法

○御園生博隆・鈴木教和・大鹿真悟・社本英二（名古屋大）

プラナリゼーション CMP とその応用(4)

9月8日 14:20~15:20 D室

D77

低照度ダブルパルスビームを用いたワイドバンドギャップ半導体のナノ表面励起加工に関する研究

○林 照剛・松永啓伍・黒河周平・横尾英昭・松川洋二（九州大）・長谷川 登・錦野将元・乙部智仁（量研機構）・熊田高之（JAEA）

D78

熔融アルカリ(NaOH)によるSiCの高速鏡面化に関する研究

○本明拓也・金子祥大・山田洋平・池野順一（埼玉大）

D79

表面吸着活性種の輸送を用いたドライ平坦化法の開発ー炭化ケイ素基板の加工ー

○宮崎俊巨・両条玲志・佐野泰久・松山智至・山内和人（大阪大）